

クリスタルボンド 555-HMP

「クリスタルボンド 555-HMP」はアテムコ社が開発した新タイプの熱可塑性仮接着剤です。555よりも融点を高めに設定しています。555同様、広範囲な電子部品のダイシング、研削、磨き作業をする際のバックアップブロックへの仮接着をするために用いられます。

特性

「クリスタルボンド 555-HMP」はノニルフェノールエトキシレートを主成分としており、セラミックス、ガラス、金属など様々な材料の接着に用いられます。

「クリスタルボンド 555-HMP」は部品を仮止めして、それほどせん断力の強くない機械加工を行う場合の一時的な破損防止に、そのギャップやミゾを充填するのに最適です。典型的な適用例としては、電子部品産業の圧電振動子、マイクロ電子素材、セラミックグリーンテープ、半導体、光学用水晶などのダイシング加工があります。

使い方

「クリスタルボンド 555-HMP」は66℃のお湯につければ流動化するので接着及び除去が容易です。膜は薄く透明なので、作業中に断面形状が観察できます。

荷姿

白色角棒状 [13x25x178mm]

10本／セット(1.5ポンド) プラスチックケース入り。

荷姿は555と同一。